(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-286772

(43)公開日 平成11年(1999)10月19日

C 2 3 C 14/06 	C 2 3 C 14/06 14/28 H 0 1 B 3/00	D L
H 0 1 B 3/00	•	L
H 0 1 B 3/00	•	
•	TO 1 R 3/00	
3/12 3 0 7	1010	F
3/12 3 0 7	3/12	307
	審査請求未請求請求	R項の数5 FD (全4頁)
(21)出願番号 特顧平10-108615	(71)出願人 396020800	
	科学技術振興	D 業事
(22)出顧日 平成10年(1998)4月2日	埼玉県川口市	本町4丁目1番8号
	(72)発明者 川合 知二	
特許法第30条第1項適用申請有り 1997年10月2日	大阪府箕面市	5小野原東 5 −26−15−615
(社) 応用物理学会発行の「1997年(平成9年)秋季	(72)発明者 田畑 仁	
第58回応用物理学会学術講演会講演予稿集No.2」に	大阪府高槻市日吉台 4 番町20-53	
発表	(74)代理人 弁理士 西澤	利夫

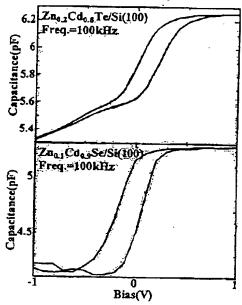
(54)【発明の名称】 カルコゲナイド系強誘電体薄膜 (57)【要約】

【課題】 不揮発性メモリー (FRAM) としても有用 なカルコゲナイド系薄膜を提供する。

【解決手段】 次式

 $A^{1}_{x}A^{2}_{1-x}B$ (A^{1} は、Zn, Cd, Hg, Al, Ga, Inおよび Tlから選択される1種以上の元素、A²は、Ai, G e, SnおよびPbから選択される1種以上の元素、B はS, SeおよびTeから選択される1種以上の元素を 示す。また、X=0~1を示し、X=0またはX=1の 場合には、 A^1 および A^2 は、各々、2種以上の元素を を示す。) で表わされる化学組成を有する薄膜であっ て、強誘電体であることを特徴とするカルコゲナイド系 強誘電体薄膜とする。

Capacitance Hysterisis



【特許請求の範囲】

【請求項1】 次式

 $A^1 \times A^2 \longrightarrow B$

 $(A^1$ は、Zn、Cd、Hg、Al、Ga、Inおよび Tl から選択される1 種以上の元素、 A^2 は、Si、Ge、Sn およびPb から選択される1 種以上の元素、B は、S、Se およびTe から選択される1 種以上の元素を示す。また、 $X=0\sim1$ を示し、X=0 またはX=1 の場合には、 A^1 および A^2 は、 A^2 は、 A^2 な、 A^3 をを示す。)で表わされる化学組成を有する薄膜であって、強誘電体であることを特徴とするカルコゲナイド系強誘電体薄膜。

【請求項2】 請求項1の薄膜において、Si基板上に 配設されていることを特徴とするカルコゲナイド系強誘 電体薄膜。

【請求項3】 請求項1または2の薄膜からなることを 特徴とするメモリー媒体。

【請求項4】 請求項1または2の薄膜の製造法であって、気相成膜により製造することを特徴とするカルコゲナイド系強誘電体薄膜の製造法。

【請求項5】 レーザーアブレーションにより成膜する 請求項4の製造法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この出願の発明は、カルコゲナイド系強誘電体薄膜に関するものである。さらに詳しくは、不揮発性メモリデバイスへの応用も可能とされるカルコゲナイド系強誘電体薄膜に関するものである。

[0002]

【従来の技術とその課題】従来より、カルコゲナイド系化合物は、PbTeやCdTeが各々赤外線センサーや太陽電池に利用される等、広範な応用が期待されている物質である。また、近年では、Mnを含むTe系化合物は希薄磁性体としても注目されている。このようなカルコゲナイド系化合物については、この出願の発明者らによって結晶成長について検討されてきているところでもある。

【0003】ただ、カルコゲナイド系化合物は、その特性が注目されながらも、実際的利用については必ずしも充分に拡がっていないのも確かである。一方、この出願の発明者らは、メモリー媒体としての強誘電体メモリー(FRAM)について検討を続けてきており、DRAMと同じ高速、大容量、低電力性を保ちながら不揮発性を備えたメモリーとしてのFRAMに注目し、その性能高度化のための方策として非酸化物系強誘電体の利用を探索してきた。それと言うのも、不揮発性メモリにおいては、Si基板への直接的成膜が必須となるが、従来では、ほとんどの強誘電体が酸化物であるために、界面に酸化シリコンが形成されて低誘電層になるという深刻な問題があったからである。

【0004】非酸化物系強誘電体としては、トリグリシン硫化物やポリビニリデン弗化物も知られているが、Si 基板上に薄膜として形成されることが知られているのは $BaMgF_4$ にとどまっている。しかし、この $BaMgF_4$ もその特性、安定性、さらには製造の点において難点があることから、新しいSi 基板上への成膜が可能な非酸化物系強誘電体の実現が望まれていた。

【0005】そこで、以上のような事情に鑑みて、この発明の発明者は、Si基板上への成膜も可能な非酸化物系強誘電体として前記カルコゲナイド系薄膜を提供することを課題としてきた。

[0006]

【課題を解決するための手段】この出願の発明は、上記の課題を解決するものとして、 次式

 $A^1 + A^2 + B$

 $(A^1$ は、Zn、Cd、Hg、Al、Ga、Inおよび Tl から選択される1 種以上の元素、 A^2 は、Si、Ge、SnおよびPb から選択される1 種以上の元素、Bk は Si、SeおよびTe から選択される1 種以上の元素を示す。また、 $X=0\sim1$ を示し、X=0 またはX=1 の場合には、 A^1 および A^2 は、 A^2 は、 A^2 は、 A^3 で表わされる化学組成を有する薄膜であって、強誘電体であることを特徴とするカルコゲナイド系強誘電体薄膜を提供する。

【0007】そして、この出願の発明は、Si基板上に配設されていることを特徴とするカルコゲナイド系強誘 電体薄膜を提供する。また、この出願の発明は、上記薄膜からなることを特徴とするメモリー媒体も提供する。 さらに、この出願の発明は、以上の薄膜の製造法であって、気相成膜により製造することを特徴とするカルコゲナイド系強誘電体薄膜の製造法と、その代表例としての、レーザーアブレーションにより成膜する製造法をも提供する。

[0008]

【発明の実施の形態】この出願の発明は、以上のとおりの特徴をもつものであるが、以下にその実施の形態について説明する。まず、この出願の発明の薄膜は、その化学組成としては、

 $A^1 \times A^2 \longrightarrow B$

として表わされ、 A^1 、 A^2 、およびBは、各々、次の 方系のうちの1種以上のものとして規定される。

[0009]

A¹:同期律表 2 B族元素 (Zn、Cd、Hg) 同期律表 3 B族元素 (Al、Go、In、Ta)

A²:同期律表4B族元素(Si、Ge、Sn、Pb)B:同期律表6B族元素(S、Se、Te)

のものとなる。たとえば、代表的な元素構成例としては、Cd-Zn-Se、Cd-Zn-Te、Ga-Ge-Te、Pb-Ge-Te、Pb-Sn-Te、Ge-Sn-Te、Ca-Ge-Se、Al-Ga-Ge-Te、Ta-Sn-Te、Cd-Si-Se等が例示される。

【0010】これらのカルコゲナイド系化合物は、Si基板上に成膜することができ、強誘電体薄膜として特徴のあるものとなる。さらに具体例として示すと、X=1の場合として、

 $Zn_y Cd_{ry}Se$

 $Z n_y C d_{1-y} T e$

(0 < y < 0.4)

を、また、

Ga_x Ge_{1-x} Te

(0.6 < x < 1)

を示すこともできる。

【0011】なお、現状においては、不揮発性メモリーへの応用のためにはSi基板が用いられるが、その用途、目的によってはそれ以外の各種のものであってもよい。チタン酸パリウム、チタン酸ストロンチウム等の各種のものが考慮される。薄膜の形成には、気相成膜法の各種のものが考慮される。真空蒸着法、スパッタリング法、レーザーアプレーション法等である。CVD法であってもよい。

【0012】なかでも、この発明においては、室温という低温条件での成膜も可能とする方法として、レーザーアブレーション法が好適なものの一つとして採用されるターゲット物質にレーザー光を照射して基板上に成膜する方法である。この方法においては、より好ましくは、希ガス(Ar等)の不活性雰囲気下、もしくは高真空下において行うのが適当である。

【0013】成膜されたこの発明のカルコゲナイド系強 誘電体薄膜は、たとえばSi基板上においては不揮発性 メモリーとして有用なものとなる。以下、実施例を示 し、さらに詳しく説明する。

[0014]

【実施例】実施例1

水素終端したp型Si (100)を基板として用い、室 温において、ArFエキシマレーザーの照射によりター ゲットのレーザーアブレーションを行い、対向する基板 上に(Zn、Cd)Te、(Zn、Cd)Seの薄膜を 各々成膜した。

【0015】なお、成膜は、Ar雰囲気($10^{-3}Torry$)において行った。図1は、 $2n_{0.1}$ $Cd_{0.9}$ Te/Si (100) および $2n_{0.1}$ $Cd_{0.9}$ Se/Si (100) のXRDパターンを示した図である。また、図2は、 $2n_{0.2}Cd_{0.8}$ Te/Si (100) および $2n_{0.1}$ $Cd_{0.9}$ Se/Si (100) の場合のC-V 曲線を示したものである。ヒステリシスが観測され、強誘電体であることが確認された。

実施例2

実施例1と同様にレーザーブレーション法によってGa Ge_{1-x} Te の薄膜を形成した。

【0016】図3はGeの含有量と抵抗との関係を示したものである。また、図4は、 $Ga_{0.85}Ge_{0.15}Te/Si(100)$ の薄膜のD-E特性を示した図である。Ga-Ge-カルコゲナイド系強誘電体薄膜の薄膜が確認された。

[0017]

【発明の効果】以上詳しく説明したとおり、この出願の発明によって、不揮発性メモリー (FRAM) への応用としても有用な、非酸化物系のカルコゲナイド系強誘電体薄膜が提供される。

【図面の簡単な説明】

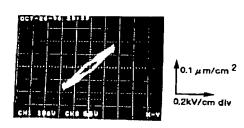
【図1】 Z n - C d - T e / S i (100)、 Z n - C d - S e / S i (100)のXRDパターンを示した図である。

【図2】 Z n - C d - T e / S i (100)、 Z n - C d - S e / S i (100)の C - V 曲線を示した図である。

【図3】 Ga-Ge-Fe/Si(100)の含有量と 抵抗との関係を示した図である。

【図4】Ga-Ge-Te/Si (100)のD-E特性を示した図である。

【図4】



(Ga_{0.85}Ge_{0.15})Te 薄膜のD-E特性

